附件1：

**第五届中国水泥智能化高峰论坛**

**参会回执**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 姓 名 | 性别 | 部门/职务 | 电 话 / 手 机 | 住宿（单/标间） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 费用总额 | 万 仟 佰 拾 元整  | 小 写 | ￥ |
| 参会方式 | D:\★王佳莹\工作\水泥网\2023年\2023智能化会议\报名二维码-带logo.png报名二维码-带logo1、推荐二维码扫码报名，方便更快捷；2、将参会回执传真或发邮件至中国水泥网（请于2023年11月21日前回传：传真**0571-85871616、**邮箱**zxh@ccement.com）** |
| 关注内容 |  |
| 付款方式 | 户 名：杭州砼福科技有限公司账 号：1202023419100017716开户行：工商银行景江苑支行**付款时请务必备注参会企业名称** |